

C600

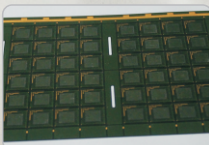
封装基板清洗机

机器介绍

全自动在线式清洗机，适用于高产能的CPU、BGA、MEMS等封装基板植球后的助焊剂清洗,采用非接触传输设计有效保护PAD面的Bumping、Solder ball等，已稳定用于各类型陶瓷基板、PCB、Substrates等湿制程工艺清洗。
该设备拥有核心技术和专利，另有多种选项功能满足用户优化工艺和控制成本。



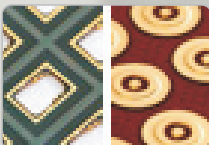
应用领域



CPU封装基板



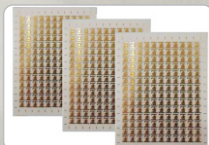
Substrates



MEMS



PBGA



陶瓷基板

广东凯尔迪清洗技术有限公司

地 址：东莞市大朗镇松木山村黄金湖工业区16号
电 话：0769-81125769
联系人：陈先生 15813865652
邮 箱：cj@kedtech.com.cn

www.gdked.com.cn

C600封装基板清洗机

C600

封装基板清洗机

详细介绍

Details Introduction

此设备采用高压喷淋的清洗方式，整机由化学清洗段、DI水漂洗段、热风干燥段组成。机器独特的传输轨道设计，产品由上下胶辊传输至各工艺段，实现完整的清洗工艺，大副提高生产效率与质量，满足高精度清洗要求。

C600

封装基板清洗机

技术资料

Technical Parameters

外形尺寸	5800mm(L)*2000mm(W)*2000mm(H)
出入板方向	左入右出（从机组正面窗口观看）
工作速度	10cm-150cm/min(可调)（建议速度为60cm/min）
传动方式	上下胶辊间通过
清洗最大尺寸	495mm（W）*240mm（L）*2.0mm（H）
清洗厚度	≤2.0mm
清洗液过滤器	5um
工作宽度	500mm
清洗方式	高压喷淋
干燥方式	高压风机热风切水
排气口尺寸	Φ200*45（H）*3PCS
电源供应	AC380V 50Hz
机器净重	4500Kg

广东凯尔迪清洗技术有限公司

地 址：东莞市大朗镇松木山村黄金湖工业区16号
电 话：0769-81125769
联系人：陈先生 15813865652
邮 箱：cj@kedtech.com.cn

www.gdked.com.cn